



TSMC, Bosch, Infineon und NXP planen Joint Venture und bringen moderne Halbleiterfertigung nach Europa

Hsinchu, Stuttgart, München, Eindhoven – 8. August 2023 – TSMC (TWSE: 2330, NYSE: TSM), Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) und NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) haben heute angekündigt, gemeinsam in das Joint Venture „European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH“ in Dresden zu investieren. Ziel ist es, eine moderne 300-Millimeter-Fabrik zur Halbleiterfertigung aufzubauen, um den zukünftigen Kapazitätsbedarf der schnell wachsenden Automobil- und Industriesektoren decken zu können. Die finale Investitionsentscheidung wird mit der Bestätigung des Umfangs der öffentlichen Förderung für das Projekt fallen. Das Projekt ist im Rahmen des europäischen Chip-Gesetzes „European Chips Act“ geplant.

Die geplante Fabrik soll eine monatliche Fertigungskapazität von 40.000 300-Millimeter-Wafern (12 Zoll) auf der 28/22-Nanometer-Planar-CMOS und 16/12-Nanometer-FinFET-Prozesstechnologie von TSMC haben. Das Joint Venture wird das europäische Halbleiter-Ökosystem mit der modernen FinFET-Transistortechnologie weiter stärken und etwa 2.000 neue und hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen. ESMC strebt an, in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 mit dem Bau der Fabrik zu beginnen und die Fertigung bis Ende 2027 aufzunehmen.

TSMC wird 70 Prozent am geplanten Joint Venture halten; Bosch, Infineon und NXP werden mit jeweils zehn Prozent beteiligt sein, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und anderer Bedingungen. Die Gesamtinvestitionen werden voraussichtlich zehn Milliarden Euro übersteigen und bestehen aus Eigenkapitalzufuhr, Kreditaufnahme sowie signifikanter Unterstützung der Europäischen Union und der deutschen Bundesregierung. TSMC wird die neue Fabrik operativ betreiben.

„Diese Investition in Dresden unterstreicht das Engagement von TSMC, den strategischen Kapazitäts- und Technologiebedarf unserer Kunden zu decken und wir freuen uns über die Gelegenheit, unsere langjährige Partnerschaft mit Bosch, Infineon und NXP zu vertiefen“, sagt Dr. CC Wei, Chief Executive Officer von TSMC. „Europa ist ein überaus vielversprechender Standort für Halbleiterinnovationen, insbesondere im Automobil- und Industriebereich, und wir freuen uns darauf, diese Innovationen auf Basis unserer fortschrittlichen Siliziumtechnologie und den Talenten in Europa zum Leben zu erwecken.“

Dr. Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH: „Halbleiter sind nicht nur ein entscheidender Erfolgsfaktor für Bosch. Ihre zuverlässige Verfügbarkeit ist auch für den Erfolg der weltweiten Automobilindustrie von großer Bedeutung. Neben dem ständigen Ausbau unserer eigenen Fertigungen, sichern wir über die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern unsere Lieferketten als Automobilzulieferer weiter ab. Wir freuen uns, mit TSMC einen globalen Innovationsführer zur Stärkung des Halbleiter-Ökosystems in direkter Nachbarschaft zu unserem Halbleiterwerk in Dresden gewinnen zu können.“

„Unsere gemeinsame Investition ist ein wichtiger Meilenstein, um das europäische Halbleiter-Ökosystem zu stärken. Damit baut Dresden, wo sich bereits der größte Frontend-Standort von Infineon befindet, die Position als eines der wichtigsten Halbleiterzentren der Welt weiter aus“, sagt Jochen Hanebeck, CEO der Infineon Technologies AG. „Infineon wird die neuen Kapazitäten nutzen, um die wachsende Nachfrage vor allem seiner europäischen Kunden zu bedienen – insbesondere in den Bereichen Automotive und IoT. Auf diesen modernen Fähigkeiten basiert die Entwicklung innovativer Technologien, Produkte und Lösungen zur Bewältigung der globalen Herausforderungen der Dekarbonisierung und Digitalisierung.“

„NXP ist entschlossen, sich maßgeblich für die Stärkung der Innovationskraft und Verbesserung der Lieferkettenresilienz in Europa zu engagieren“, sagt Kurt Sievers, Präsident und CEO von NXP Semiconductors. „Wir danken der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und dem Freistaat Sachsen für die Anerkennung der Halbleiterindustrie als strategisch wichtigen Industriesektor und für ihren großen Einsatz zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems. Der Bau dieser neuen, hochrelevanten Halbleiter-Foundry wird die dringend benötigte Produktionskapazität für den stark wachsenden Bedarf des Automobil- und Industriesektors für Digitalisierung und Elektrifizierung bereitstellen und neues Innovationspotenzial freisetzen.“

Über Bosch

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit weltweit rund 421.000 Mitarbeitenden (Stand: 31.12.2022). Sie erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 88,2 Milliarden Euro. Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmensbereiche Mobility, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology. Als führender Anbieter im Internet der Dinge (IoT) bietet Bosch innovative Lösungen für Smart Home, Industrie 4.0 und Connected Mobility. Bosch verfolgt die Vision einer nachhaltigen, sicheren und begeisternden Mobilität. Mit seiner Kompetenz in Sensorik, Software und Services sowie der eigenen IoT-Cloud ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden vernetzte und domänenübergreifende Lösungen aus einer Hand anzubieten. Strategisches Ziel der Bosch-Gruppe sind Lösungen und Produkte für das vernetzte Leben, die entweder über künstliche Intelligenz (KI) verfügen oder mit ihrer Hilfe entwickelt oder hergestellt werden. Mit innovativen und begeisternden Produkten sowie Dienstleistungen verbessert Bosch weltweit die Lebensqualität der Menschen. Bosch bietet „Technik fürs Leben“. Die Bosch-Gruppe

umfasst die Robert Bosch GmbH sowie ihre rund 470 Tochter- und Regionalgesellschaften in mehr als 60 Ländern. Inklusive Handels- und Dienstleistungspartnern erstreckt sich der weltweite Fertigungs-, Entwicklungs- und Vertriebsverbund von Bosch über fast alle Länder der Welt. Mit ihren weltweit mehr als 400 Standorten ist die Bosch-Gruppe seit Frühjahr 2020 CO2-neutral. Basis für künftiges Wachstum ist die Innovationskraft des Unternehmens. Bosch beschäftigt weltweit rund 85.500 Mitarbeitende in Forschung und Entwicklung an 136 Standorten, davon etwa 44.000 Software-Entwicklerinnen und -Entwickler. Mehr Informationen unter www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.twitter.com/BoschPresse.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiter-lösungen für Power-Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 56.200 Beschäftigten und erzielte im Geschäftsjahr 2022 (Ende September) einen Umsatz von rund 14,2 Milliarden Euro.

Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com.

Follow us: [Twitter](#) – [Facebook](#) – [LinkedIn](#)

Über NXP Semiconductors

NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) bringt kluge Köpfe zusammen, um wegweisende Technologien zu entwickeln, die die vernetzte Welt besser, zuverlässiger und sicherer machen. Als ein weltweit marktführendes Unternehmen bei Lösungen für sichere Kommunikation in Embedded Applikationen treibt NXP Innovationen in den Anwendungsfeldern Automobiltechnik, Industrie & IoT, bei Mobilgeräten und Kommunikationsinfrastruktur voran und fördert mit seinen Lösungen eine nachhaltigere Zukunft. Das Unternehmen, das auf die Erfahrung und Expertise von mehr als 60 Jahren bauen kann, beschäftigt ca. 34.500 Mitarbeitende in mehr als 30 Ländern und erzielte 2022 einen Umsatz von 13,21 Milliarden US-Dollar. Weitere Details unter www.nxp.com.

Über TSMC

TSMC ist ein Pionier des Pure-Play-Foundry-Geschäftsmodells, das 1987 mit TSMCs Gründung ins Leben gerufen wurde, und ist seither die weltweit führende dezidierte Halbleiter-Foundry. Mit branchenführenden Prozesstechnologien und einem Portfolio an Design-Enablement-Lösungen unterstützt das Unternehmen ein florierendes Ökosystem von globalen Kunden und Partnern, um das Innovationspotenzial in der globalen Halbleiterindustrie freizusetzen. TSMC ist ein auf der ganzen Welt engagiertes Unternehmen mit Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika.

Im Jahr 2022 setzte TSMC 288 verschiedene Prozesstechnologien ein und fertigte 12.698 Produkte für 532 Kunden, indem es eine breite Palette an modernen Prozesstechnologien sowie fortschrittlichen Spezial- und Packaging-Technologien anbot. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hsinchu, Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.tsmc.com>.

Die englische Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

#

Pressekontakte

Robert Bosch GmbH

Athanassios Kaliudis

Pressesprecher Vernetzte Mobilität, Software und Automobilelektronik

Tel: +49 152 08651292

E-Mail: athanassios.kaliudis@de.bosch.com

Infineon Technologies AG

Andre Tauber

Head of Corporate Media Relations

Tel: +49 89 234-36705

E-Mail: Andre.Tauber@infineon.com

NXP Semiconductors

Mike Silverman

Sr. Director of Global Public Relations

Mobile: +1 979-350-9210

E-Mail: Mike.Silverman@nxp.com

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.

Nina Kao

Head of Public Relations

Tel: +886-3-563-6688 Durchwahl 7125036

Mobil: +886-988-239-163

E-Mail: nina_kao@tsmc.com

Ulric Kelly

Public Relations

Tel: +886-3-563-6688 Durchwahl 7126541

Mobil: +886-978-111-503

E-Mail: ukelly@tsmc.com